



本社：〒160-8366  
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号  
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20111207001  
2011 年 12 月 8 日

## お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 カスタムドキュメント  
マネージャ 牧 達郎 

### HVAL/HPA DCUパッケージ 一部製品 組立検査サイト追加のご案内

平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

タイにおける大洪水の影響により、HANA 社(タイ)サイトを含む数カ所の弊社協力工場における生産が、暫定的に被害を受けております。

TI は、連日、生産/流通拠点パートナーからの状況連絡を受けながら、供給面での致命的影響を緩和する為に、代替製造工場の選定及び認定を含む様々な施策を行っております。

今回のお知らせは、代替組立検査工場追加の連絡になります。お客様への供給停滞を最小限にとどめる為に、本通知内で明記したパッケージ製品について、追加工場への生産移管に向け早急に対応いたしております。

TI は、現行最善の情報/知識に基づき生産移管に必要な全てを本通知に盛り込むべく全ての方策を行っていますが、変更があった場合にも同様に本通知の更新版にて連絡いたします。さらに、選定された代替工場をより効率的に利用できると判断した時点で、これらに関連する供給移管に伴う PCN を発行する場合があります。

TI は、各生産拠点での認定状況を基に生産拠点選定及びパッケージ認定試験による前述の移管施策に加え、お客様への製品納入に先立ち、選別工程での歩留まり/選別分類比較評価を行う事でお客様での懸念事項の払拭に向け進めてまいります。また、供給の遅れを最小限にとどめると共に、品質を伴った製品の供給に努めてまいります。

次ページに詳細を掲載いたしました。お客様におかれましては、本通知発行日より **21** 日以内に、本通知受領のご確認をお願いいたします。供給遅延を最小限にとどめるために、TI は部材供給可能な代替工場での生産を 2012 年 5 月の出荷が開始されるべくすでに施策の実施を開始しいたしております。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

ご不明な点、ご質問等ございましたら、担当営業あるいは [pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com) にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Test	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling	<input type="checkbox"/> -	
変更内容	HVAL/HPA DCU パッケージ 一部製品 組立検査サイト追加 現行 : HANA 社(タイ) 変更後: HANA 社(タイ), ASE 社(上海, 中国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2012 年 5 月の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input checked="" type="checkbox"/> 計画	<input type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容: 弊社 HVAL(ハイボリュームアナログロジック)/HPA(ハイパフォーマンスアナログ) DCUパッケージ 一部製品の組立検査サイトについて、現行 HANA社(タイ)サイトにて製造していますが、HANA社(タイ)サイト一時的閉鎖による供給能力確保の為に、これに加えて、ASE社(上海, 中国)サイトを追加します。組立部材変更については下表を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立検査サイト	HANA社(タイ)	HANA社(タイ) ASE社(上海, 中国)

	現行	追加認定
組立検査サイト	Hana-Thai	ASE-Shanghai
モールド樹脂	450207	EN2000508
ボンディングワイヤ(径, 部材)	0.8 mil, Au	0.8 mil, Au
リードフレーム(表面処理, 部材)	NiPdAu, Cu	Matte-Sn, Cu

理由: HANA 社(タイ)サイト一時的閉鎖による供給能力確保の為

詳細:

本変更実施以降、対象製品の鉛フリー対応製品は単一製品名に統一されます。例えば、SN74AUC2G32DCUR の製品名で Matte-Sn もしくは NiPdAu 表面処理の SN74AUC2G32DCUR 製品が出荷されることとなります。

対象製品リスト

対象製品名				
OPA1662A1DCUR	SN74AUP1G99DCUT	SN74LVC1G123DCUR	SN74LVC2G241DCUR	SN74LVC3G14DCUT
OPA1662A1DCUT	SN74AUP2G00DCUR	SN74LVC1G123DCUT	SN74LVC2G241DCUR	SN74LVC3G17DCUR
OPA2170A1DCUR	SN74AUP2G02DCUR	SN74LVC1G139DCUR	SN74LVC2G32DCUR	SN74LVC3G34DCUR
OPA2170A1DCUT	SN74AUP2G08DCUR	SN74LVC1G139DCUT	SN74LVC2G32DCUT	SN74LVC3G34DCUT
OPA2171A1DCUR	SN74AUP2G125DCUR	SN74LVC1G29DCUR	SN74LVC2G38DCUR	SN74LVC3GU04DCUR
OPA2171A1DCUT	SN74AUP2G126DCUR	SN74LVC1G29DCUT	SN74LVC2G38DCUT	SN74TVC3306DCUR
PCA9306DCUR	SN74AUP2G240DCUR	SN74LVC1G74DCUR	SN74LVC2G53DCUR	TCA9406DCUR
PCA9306DCUT	SN74AUP2G241DCUR	SN74LVC1G74DCUT	SN74LVC2G53DCUT	TS5A2053DCUR
SN0710021DCUR	SN74AUP2G32DCUR	SN74LVC1G99DCUR	SN74LVC2G66DCUR	TS5A2066DCUR
SN74AUC1G74DCUR	SN74AUP2G79DCUR	SN74LVC1G99DCUT	SN74LVC2G66DCUT	TS5A21366DCUR
SN74AUC2G00DCUR	SN74AUP2G80DCUR	SN74LVC2G00DCUR	SN74LVC2G74DCUR	TS5A23166DCUR
SN74AUC2G02DCUR	SN74AUP3G04DCUR	SN74LVC2G00DCUT	SN74LVC2G74DCUT	TS5A23167DCUR
SN74AUC2G08DCUR	SN74AUP3G06DCUR	SN74LVC2G02DCUR	SN74LVC2G79DCUR	TS5A26466DCUR
SN74AUC2G125DCUR	SN74AUP3G07DCUR	SN74LVC2G02DCUT	SN74LVC2G80DCUR	TS5A3153DCUR
SN74AUC2G126DCUR	SN74AUP3G14DCUR	SN74LVC2G08DCUR	SN74LVC2G86DCUR	TS5A3154DCUR
SN74AUC2G240DCUR	SN74AUP3G17DCUR	SN74LVC2G08DCUT	SN74LVC2G86DCUT	TS5A3357DCUR
SN74AUC2G241DCUR	SN74AUP3G34DCUR	SN74LVC2G125DCUR	SN74LVC2T45DCUR	TS5A3357DCUT
SN74AUC2G32DCUR	SN74AVC2T45DCUR	SN74LVC2G125DCUT	SN74LVC2T45DCUT	TS5A3359DCUR
SN74AUC2G53DCUR	SN74AVC2T45DCUT	SN74LVC2G126DCUR	SN74LVC3G04DCUR	TS5A3359DCUT
SN74AUC2G66DCUR	SN74AVCH2T45DCUR	SN74LVC2G126DCUT	SN74LVC3G04DCUT	TXB0102DCUR
SN74AUC2G79DCUR	SN74AVCH2T45DCUT	SN74LVC2G132DCUR	SN74LVC3G06DCUR	TXB0102DCUT
SN74AUC2G80DCUR	SN74CB3Q3305DCUR	SN74LVC2G132DCUT	SN74LVC3G06DCUT	TXS0102DCUR
SN74AUC2G86DCUR	SN74CB3Q3306ADCUR	SN74LVC2G157DCUR	SN74LVC3G07DCUR	TXS0102DCUT
SN74AUP1G74DCUR	SN74CB3T3306DCUR	SN74LVC2G157DCUT	SN74LVC3G07DCUT	
SN74AUP1G99DCUR	SN74LVC1404DCUR	SN74LVC2G240DCUR	SN74LVC3G14DCUR	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L)が下記の様になります。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)
現行	Hana-Thai	ASO: HNT
追加認定	ASE-Shanghai	ASO: ASH

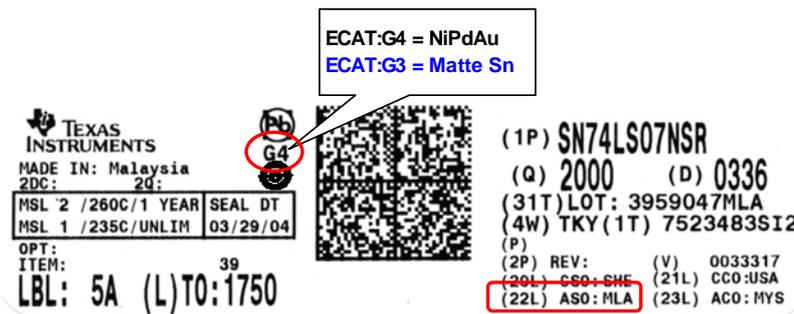


図1 出荷ラベルの例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年3月	終了	2012年5月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74AUP2G08DCUR	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	VSSOP/DCU/8	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Mold Compound:	EN2000508	
MSL:	JEDEC L-1/260C	Leadframe (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 96 hrs	77	77	-
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	-
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	-
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年3月	終了	2012年5月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74AUP3G04DCUR	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	VSSOP/DCU/8	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Mold Compound:	EN2000508	
MSL:	JEDEC L-1/260C	Leadframe (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 96 hrs	77	77	
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年3月	終了	2012年5月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TXB0102DCUR	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	VSSOP/DCU/8	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Mold Compound:	EN2000508	
MSL:	JEDEC L-1/260C	Leadframe (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500 hrs	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 hrs	77	77	77
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年3月	終了	2012年5月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74LVC2G74DCUR	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	VSSOP/DCU/8	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Mold Compound:	EN2000508	
Leadframe (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Test MQ	FT yield and bin summary	per spec	per spec	per spec
Solderability	Steam age 8 hrs; Pb-Free Solder	22	22	22
Physical Dimensions	per mechanical drawing	10	10	10

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年3月	終了	2012年5月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA1662AIDCUR	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	VSSOP/DCU/8	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Mold Compound:	EN2000508	
MSL:	JEDEC L-1/260C	Leadframe (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 hrs	77	77	77
High Temp Operating Life	150C, 300 hrs	77	77	77
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年3月	終了	2012年5月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA2170AIDCUR	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	VSSOP/DCU/8	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au	Mold Compound:	EN2000508	
MSL:	JEDEC L-1/260C	Leadframe (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	—	終了
2011年6月24日			
信頼性試験 - 試料構成詳細			
ID:	Device1	Device2	
Qual Device:	RC4558PWR	SN74LV14APWR	
Assembly Site:	ASESH	ASESH	
Package/Code/Pins:	TSSOP/PW/8	TSSOP/PW/14	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu	1.0 Mil Dia., Cu	
Mold Compound:	EN2000508	EN2000508	
Leadframe (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	JEDEC L-1/260C	
ID:	Device3	Device4	
Qual Device:	SN74LVC14APWR	ULN2003APW	
Assembly Site:	ASESH	ASESH	
Package/Code/Pins:	TSSOP/PW/14	TSSOP/PW/16	
Mold Compound:	EN2000508	EN2000508	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu	1.0 Mil Dia., Cu	
Leadframe (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	JEDEC L-1/260C	
信頼性試験結果			
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails	
		Device1	Device2
High Temp Operating Life	150C, 300 hrs	77/0	77/0
Electrical Characterization	-	Approved	Approved
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 hrs	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	Approved
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails	
		Device3	Device4
High Temp Operating Life	150C, 300 hrs	77/0	77/0
Electrical Characterization	-	Approved	Approved
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 hrs	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	Approved
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C			